

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60191-2U

Première édition
First edition
1997-04

Dix-neuvième complément
à la Publication 60191-2 (1966)

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs**

**Partie 2:
Dimensions**

Nineteenth supplement
to Publication 60191-2 (1966)

**Mechanical standardization of semiconductor
devices**

**Part 2:
Dimensions**

*Les feuilles de ce complément sont à insérer dans la
Publication 60191-2
The sheets contained in this supplement are to be inserted
in Publication 60191-2*

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



CODE PRIX
PRICE CODE

F

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 60191-2**

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page de titre.

Retirer la page 60191 IEC I existante contenant la préface et la remplacer par la nouvelle page 60191 IEC I contenant la préface au dix-neuvième complément.

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

60191 IEC I-100E - a/b/c/d

60191 IEC I-123E - a/b/c

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 60191-2**

Replace the existing title page with the new title page.

Remove the existing page 60191 IEC I containing the preface and insert in its place the new page 60191 IEC I containing the preface to the nineteenth supplement.

Chapter I:

Add the following new sheets:

60191 IEC I-100E - a/b/c/d

60191 IEC I-123E - a/b/c

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
60191-2**
Première édition
First edition
1966

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974), F (1976), G (1978), H (1978), J (1980), K (1981),
L (1982), M (1983), N (1987), P (1988), Q (1990), R (1995), S (1995), T (1995) et/and U (1997)

**Dix-neuvième complément
à la Publication 60191-2 (1966)**

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs**

**Partie 2:
Dimensions**

**Nineteenth supplement
to Publication 60191-2 (1966)**

**Mechanical standardization of semiconductor
devices**

**Part 2:
Dimensions**



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PUBLICATION 191-2

NORMALISATION MÉCANIQUE
DES DISPOSITIFS À
SEMICONDUCTEURS

DEUXIÈME PARTIE: DIMENSIONS

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

PRÉFACE

CONCEPTION DE LA NORMALISATION
MÉCANIQUE Chapitre 00

VALEURS RECOMMANDÉES POUR
CERTAINES DIMENSIONS
DE DESSINS DE DISPOSITIFS
À SEMICONDUCTEURS Chapitre 0

DESSINS D'ENCOMBREMENTS Chapitre I

TYPES DE DISPOSITIFS À
SEMICONDUCTEURS GÉNÉRALEMENT
MONTÉS DANS LES BOÎTIERS
DU CHAPITRE I

DESSINS D'EMBASES Chapitre II

DESSINS DE BOÎTIERS Chapitre III

DESSINS DE CALIBRES Chapitre IV

TABLEAUX MONTRANT LES
ASSOCIATIONS ENTRE LES BOÎTIERS
ET LES EMBASES Chapitre V

DESSINS OBSOLÈTES

COMPLÉMENTS AUX LISTES DE CODES
NATIONAUX FIGURANT SUR LES
FEUILLES DES NORMES DE
LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI

SUPPRESSIONS DANS LES LISTES
DE CODES NATIONAUX FIGURANT
SUR LES FEUILLES DE NORMES DE
LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PUBLICATION 191-2

MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

PART 2: DIMENSIONS

CONTENTS

FOREWORD

PREFACE

PHILOSOPHY OF MECHANICAL
STANDARDIZATION Chapter 00

RECOMMENDED VALUES FOR
CERTAIN DIMENSIONS OF
DRAWINGS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES Chapter 0

DEVICE OUTLINE DRAWINGS Chapter I

TYPES OF SEMICONDUCTOR DEVICES
GENERALLY MOUNTED IN THE
PACKAGES OF CHAPTER I

BASE DRAWINGS Chapter II

CASE OUTLINE DRAWINGS Chapter III

GAUGE DRAWINGS Chapter IV

TABLES SHOWING ASSOCIATIONS
BETWEEN CASE OUTLINES AND
BASES Chapter V

OBSOLETE DRAWINGS

ADDITIONS TO THE LISTS OF
NATIONAL CODES APPEARING ON
THE STANDARD SHEETS OF
IEC PUBLICATION 191-2

DELETIONS TO THE LISTS OF
NATIONAL CODES APPEARING ON
THE STANDARD SHEETS OF
IEC PUBLICATION 191-2

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Dix-neuvième complément à la CEI 60191-2 (1966)

NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 2: Dimensions

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

PRÉFACE AU DIX-NEUVIÈME COMPLÉMENT

La présente norme a été établie par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs, et par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Elle constitue le dix-neuvième complément à la CEI 60191-2.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47D/118+146/FDIS	47D/154+159/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Nineteenth supplement to IEC 60191-2 (1966)

**MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES –****Part 2: Dimensions**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

PREFACE TO THE NINETEENTH SUPPLEMENT

This standard has been prepared by sub-committee 47D: Mechanical standardization of semiconductor devices, and by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

It forms the nineteenth supplement to IEC 60191-2.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47D/118+146/FDIS	47D/154+159/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

CHAPITRE 00 — CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE

1. Règles fondamentales

Lors de la réunion tenue à Montreux (juin 1981), le Comité d'Etudes n° 47 adopta les règles fondamentales suivantes qui remplacent celles adoptées à Copenhague en octobre 1962:

- A. Toute proposition nouvelle devra être soumise à l'étude préliminaire d'un groupe de travail convenablement qualifié (note 1) avant circulation dans un document Secrétariat.
- B. Le groupe de travail qualifié devra étudier les nouvelles propositions avec les objectifs suivants:
 1. Aboutir à une normalisation active en n'acceptant que les boîtiers qui sont soutenus internationalement.
 2. Spécifier de façon précise les dimensions en vue d'assurer l'interchangeabilité et de faciliter les manipulations automatiques.
 3. Reconsidérer continuellement les dessins existants et proposer la suppression de ceux qui ne sont plus soutenus.
- C. Il ne sera procédé à la discussion d'un dessin de boîtier que s'il a le soutien préalable d'au moins trois pays.
- D. Un dessin ne sera introduit dans la Publication 191-2 de la CEI que si au moins trois des pays qui le soutiennent ont fourni leur numéro de code national (ou exprimé un soutien formel s'ils ne possèdent pas de numéro de code).

Notes 1. — Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Orlando (février 1980), il a été admis d'étendre le domaine d'activité du GT7 de façon qu'il couvre aussi bien la normalisation mécanique des semiconducteurs discrets que celle des circuits intégrés.

Il a été également admis que, compte tenu de l'élargissement de son domaine d'activité, le GT7 serait le groupe de travail qualifié mentionné dans le paragraphe A.

En vue d'éviter que l'introduction du GT7 dans le processus suivi par le Comité d'Etudes n° 47 pour préparer des documents secrétariat sur la normalisation mécanique provoque des délais supplémentaires, le GT7 a été autorisé à obtenir de la part des trois pays concernés, ou plus, la confirmation directe du maintien de leur appui pour ces propositions.

2. — Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Montreux (juin 1981) il a été admis que les réunions du GT7 s'intégreraient dans les réunions du Comité d'Etudes n° 47.

Cependant, certaines propositions peuvent nécessiter un temps d'étude dépassant la durée d'une réunion du Comité d'Etudes n° 47 et en conséquence requérir une ou plusieurs réunions du GT7 entre deux réunions consécutives du Comité d'Etudes n° 47.

Lors de la réunion tenue à Moscou (juin 1977), le Comité d'Etudes n° 47 adopta la règle suivante:

Lorsqu'un dessin de la Publication 191-2 de la CEI vient à ne plus être soutenu que par un seul pays, il sera retiré de la publication principale et transféré dans une section séparée intitulée «Dessins obsolètes» avec l'indication de la date de transfert sur la feuille particulière correspondante.

Un avertissement, au début de la section dévolue aux dessins obsolètes, stipulera qu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa date de transfert, le dessin sera supprimé, sauf s'il est soutenu par un autre pays dans l'intervalle.

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste de dessins (suite)

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
105B07 105B08 105B09	105B07 105B08 105B09	I105B	1988
106B01 105V02	106B01 SC-68	I-106B	1988
107B01 107B02	107B01 SC-69	I-107B	1988
Forme C 100C01 100C02	KD10	I-100C	1990
Forme E 046E01A 046E01B	NT23/3A NT23/3B	I-46E1	1988
046E02A 046E02B	NT143A NT143B	I-46E2	1988
075E01 075E02 075E03 075E04 075E05 075E06	SO192E SO192F NT162 NT163 NT137 NT136	I-075E	1990
076E01S 076E01L 066E02S 076E02L 076E03S 076E03L 076E04S 076E04L 066E05S 076E05L 076E06S 076E06L 076E07S 076E07L 099E	F174A F174 F175A F175 F176A F176 F177A F177 F178A F178 F179A F179 F180A F180	I-076E	1990
		I-099E	1995
100E	NT323 SC-70	I-100E	1996
102E02 102E03 102E04 102E05 102E06 102E07	MS004-CB MS004-CC MS004-CD MS004-CE MS004-CF MS004-CG	I-102E	1990
112E01 112E02 112E03 112E04 112E05 112E06 112E07 112E08 112E09 112E10 112E11 112E12 112E13 112E14 112E15	B1A (Allemagne) B1C SO195A B1D (Allemagne) B1E SO195B B1G NT185 SO195D NT188 NT189 MO-047AG MO-047AH	I-112E	1990

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)

IEC code number	Code of country or origin	Page number and date	
105B07 105B08 105B09	105B07 105B08 105B09	I105B	1988
106B01 105V02	106B01 SC-68	I-106B	1988
107B01 107B02	107B01 SC-69	I-107B	1988
Form C 100C01 100C02	KD10	I-100C	1990
Form E 046E01A 046E01B	NT23/3A NT23/3B	I-46E1	1988
046E02A 046E02B	NT143A NT143B	I-46E2	1988
075E01 075E02 075E03 075E04 075E05 075E06	SO192E SO192F NT162 NT163 NT137 NT136	I-075E	1990
076E01S 076E01L 066E02S 076E02L 076E03S 076E03L 076E04S 076E04L 066E05S 076E05L 076E06S 076E06L 076E07S 076E07L 099E	F174A F174 F175A F175 F176A F176 F177A F177 F178A F178 F179A F179 F180A F180	I-076E	1990
		I-099E	1995
100E	NT323 SC-70	I-100E	1996
102E02 102E03 102E04 102E05 102E06 102E07	MS004-CB MS004-CC MS004-CD MS004-CE MS004-CF MS004-CG	I-102E	1990
112E01 112E02 112E03 112E04 112E05 112E06 112E07 112E08 112E09 112E10 112E11 112E12 112E13 112E14 112E15	B1A (Germany) B1C SO195A B1D (Germany) B1E SO195B B1G NT185 SO195D NT188 NT189 MO-047AG MO-047AH	I-112E	1990

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste de dessins (suite)

Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
114E01	NT89	I-114E	1988
115E01	SC-527-8AA	I-115E	1988
115E02	SC-528-10AA		
115E03	SC-529-14AA		
115E04	SC-530-16AA		
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(Etats-Unis)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E01	NT205	I-133E	1994
133E02	NT208		
133E03			
134E01	NT220	I-134E	1994
134E02	NT224		
134E03	NT219		
134E04			
135E01	NT225	I-135E	1994
135E02	NT210		
135E03			
Forme F		I-084F	1996
084F			
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1988
101F01	101F01		
102F0	102F01	I-102F	1994
102F02	102F02		
102F033	102F03		
Forme G		I-50a/b/c/d	1985
050G01	SO5-87D		
050G02	SO-188D		
050G03	SO-87A		
050G04	SO-87B		
050G05	SO-188A		
050G06	SO-188B		
050G07	SO-188F		
050G08	SO-87C		
050G10	SO-188C		
050G11	SC505-18A		
050G12	SO-87G		
050G13	SO-188E		
050G14	(Suède)		
050G16	A1AA		
050G17	A1AB		
050G18	A1BA		
050G19	A1BB		
050G20	A1CB		

Publication 60191-2, chapitre I
(Dix-neuvième complément)

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)

IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
114E01	NT89	I-114E	1988
115E01	SC-527-8AA	I-115E	1988
115E02	SC-528-10AA		
115E03	SC-529-14AA		
115E04	SC-530-16AA		
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(USA)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E01	NT205	I-133E	1994
133E02	NT208		
133E03			
134E01	NT220	I-134E	1994
134E02	NT224		
134E03	NT219		
134E04			
135E01	NT225	I-135E	1994
135E02	NT210		
135E03			
Form F		I-084F	1996
084F			
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1988
101F01	101F01		
102F0	102F01	I-102F	1994
102F02	102F02		
102F033	102F03		
Form G		I-50a/b/c/d	1985
050G01	SO5-87D		
050G02	SO-188D		
050G03	SO-87A		
050G04	SO-87B		
050G05	SO-188A		
050G06	SO-188B		
050G07	SO-188F		
050G08	SO-87C		
050G10	SO-188C		
050G11	SC505-18A		
050G12	SO-87G		
050G13	SO-188E		
050G14	(Sweden)		
050G16	A1AA		
050G17	A1AB		
050G18	A1BA		
050G19	A1BB		
050G20	A1CB		

Publication 60191-2, Chapter I
(Nineteenth supplement)

Types de dispositifs à semiconducteurs
généralement montés dans les boîtiers
du chapitre I de la CEI 60191-2

Types of semiconductor devices
generally mounted in the packages
of chapter I of IEC 60191-2

Type de dispositif Type of device	Numéro de code CEI du dessin du boîtier IEC code number of package drawing
Diodes de signal et diodes Zener de faible puissance Signal diodes and small-power Zener diodes	A1, A20, A24, A32, A54, A55, A58, A67, A69, A70, A71, 098H, 100H
Diodes hyperfréquences Microwave diodes	A18
Diodes de redressement de faible et moyenne puissance Rectifier diodes, small and medium power	A2, A3, A4, A6, A7, A19, A37, A44, A74, 077B, 100B
Diodes de redressement de forte puissance High-power rectifier diodes	A8, A9, A10, A15, A16, A17, A21, A22, A35, 083B, 103B
Thyristors de faible et moyenne puissance Thyristors, small and medium power	A11, A13, A14, A38, A43
Thyristors de forte puissance High-power thyristors	A12, A27, A28, A29, A34, A39, A47, 104B, 105B
Transistors de signal Signal transistors	A36, A40, A41, 068A, 046E, 114E
Transistors de puissance Power transistors	A23, A30, A31, A43, A48, A56, A57, A45, A73, 080B, 081B, 082B, 101B, 102B, 120E, 084F, P100F
Transistors hyperfréquences Microwave transistors	A26, A42, A43, A59, A66, A72, 100C
Dispositifs optoélectroniques Optoelectronic devices	A62, A64, A65, A63A, 100A, 101A, 106B, 107B
Circuits intégrés Integrated circuits	A52, A53, A61, 075E, 076E, 099E, 100E, 102E, 112E, 115E, 116E, 117E, 118E, 119E, 121E, 122E, 123E, 129E, 133E, 134E, 135E, 102F, 050G, 051G, 060G, 100G, 101G

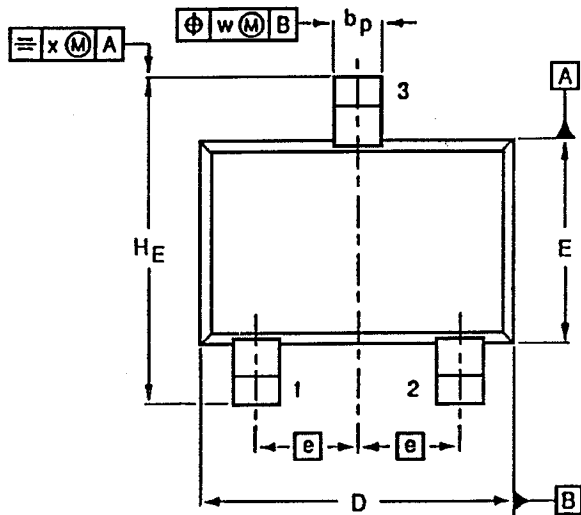


Figure 1a

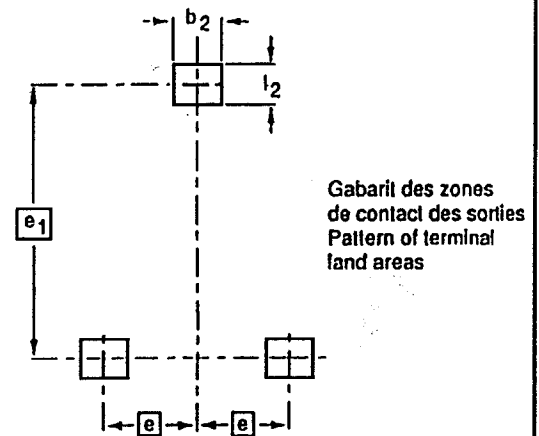


Figure 1b

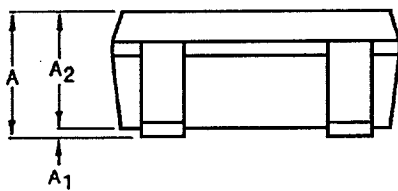


Figure 1c

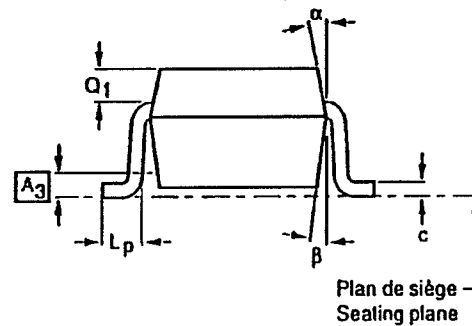


Figure 1d

Figure 1 – Gabarit des zones de contact des sorties
Pattern of terminal land areas

Encombrement des transistors de forme E
 Transistor outline of form E

Date: 1996

60191 IEC I-100E - a

Publication CEI

No 60191

IEC Publication

Groupe 1 – Dimensions appropriées pour le montage et l'interchangeabilité Group 1 – Dimensions appropriate to mounting and interchangeability								
Réf./Ref.	Millimètres/Millimetres			Inches				Notes
	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Degrés/ Degrees	
A	–	–	1,1	–	–	0,043		
A ₁	–	–	0,1	–	–	0,0039		
A ₂	0,8	–	–	0,032	–	–		
A ₃	–	0,2*	–	–	0,0079*	–		
b _p	0,20	–	0,40	0,08	–	0,015		
e	–	0,65*	–	–	0,0256*	–		
H _E	1,8	–	2,4	0,071	–	0,094		
L _p	0,15	–	–	0,006	–	–		
w	–	–	0,2	–	–	0,0078		
x	–	–	0,2	–	–	0,0078		
* Signifie position géométrique exacte. Means true geometrical position.								
Groupe 2 – Dimensions appropriées pour le montage et le contrôle par calibre Group 2 – Dimensions appropriate to mounting and gauging								
Réf./Ref.	Millimètres/Millimetres			Inches				Notes
	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Degrés/ Degrees	
b ₂	–	0,6	–	–	0,023	–		1
e	–	0,65*	–	–	0,0256*	–		1
e ₁	–	1,9*	–	–	0,0748*	–		1
l ₂	–	0,5	–	–	0,020	–		1
* Signifie position géométrique exacte. Means true geometrical position.								
Groupe 3 – Dimensions appropriées pour la manipulation automatique Group 3 – Dimensions appropriate to automated handling								
Réf./Ref.	Millimètres/Millimetres			Inches				Notes
	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Degrés/ Degrees	
A ₂	0,8	–	–	0,032	–	–		
D	1,8	–	2,2	0,071	–	0,086		
E	1,10	–	1,35	0,044	–	0,053		
Q ₁	0,10	–	–	0,004	–	–		
Encombrement des transistors de forme E Transistor outline of form E								
Date: 1996								
60191 IEC I-100E - b						Publication CEI IEC Publication		
						No 60191		

Groupe 4 – Dimensions pour information seulement Group 4 – Dimensions for information only								
	Millimètres/Millimetres			Inches				Notes
Réf./Ref.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Degrés/ Degrees	
c	0,10	—	0,26	0,004	—	0,010		
∞	—	—	—	—	—	—	17	2
NOTES 1 Le contrôle des dimensions et des positions des sorties est valablement réalisé lorsqu'on s'assure que ces sorties s'ajustent avec le gabarit des zones de contact des sorties. Cela peut être réalisé à l'aide d'un calibre approprié. 2 Applicable à deux côtés.				NOTES 1 Check of the dimensions and positions of package terminals is validly performed when it is ensured that these terminals fit with the pattern of terminal land areas. This can be carried out by means of an appropriate gauge. 2 Applicable to two sides.				
			Encombrement des transistors de forme E Transistor outline of form E			Date: 1996		
60191 IEC I-100E - c						Publication CEI IEC Publication		No 60191

Pays ou organisation Country or organization	Code
CEI/IEC	100E
Pays-bas Netherlands	NT 323
Japon Japan	SC-70

Encombrement des transistors de forme E
Transistor outline of form E

Date: 1996

60191 IEC I-100E - d

Publication CEI

No 60191

IEC Publication

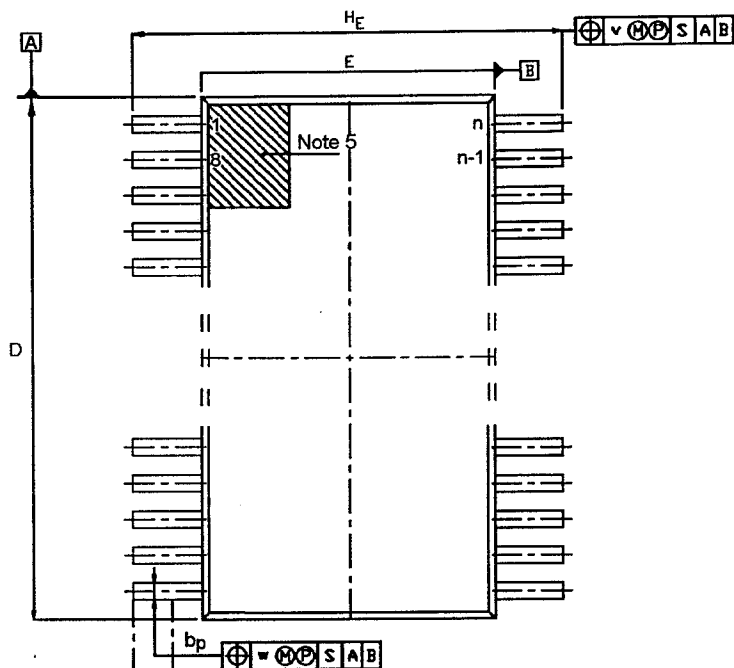


Figure 1a

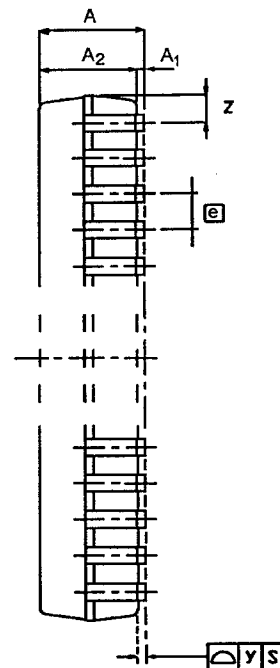


Figure 1c

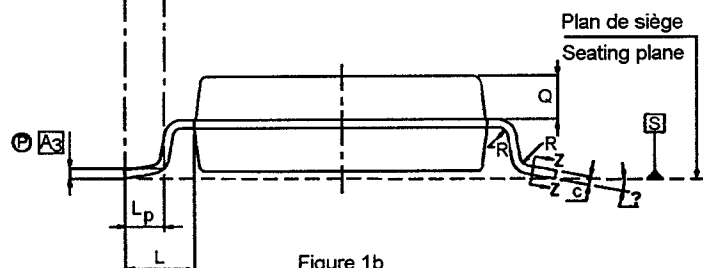
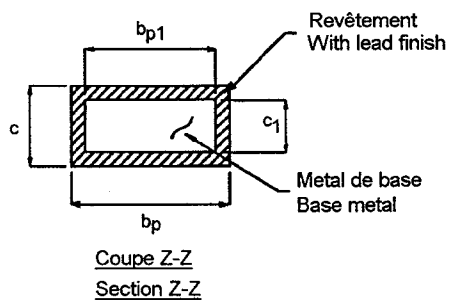
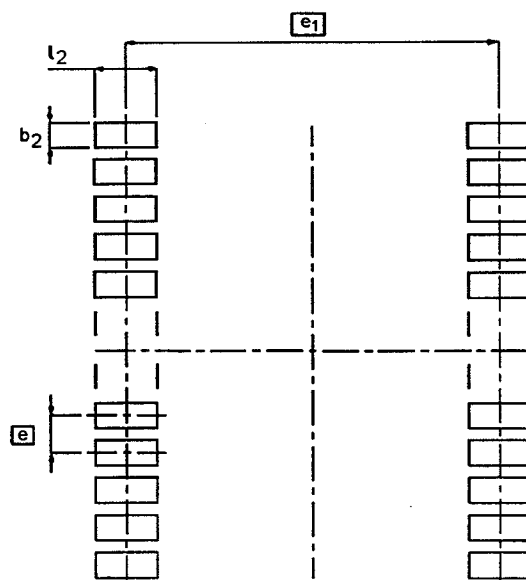
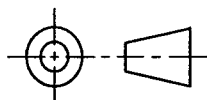


Figure 1b

Coupe Z-Z
Section Z-ZFigure 2
Position des broches
Lead position overlay

Famille d'encombrement R-PDSO-G
Outline family R-PDSO-G

Date: 1997

Groupe 1 – Dimensions appropriées pour le montage et l'interchangeabilité
Group 1 – Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Réf. Ref	Min.	Nom.	Max.	Notes
A	–	–	2,0	
A ₁	0,05	–	–	9
A ₂	1,65	1,75	1,85	
A ₃	–	0,25(*)	–	
b _p	0,22	–	0,38	4, 7, 8
b _{p1}	0,22	0,30	0,33	4, 7, 8
E	5,0	5,30	5,60	6
e	–	0,65(*)	–	4
H _E	7,40	7,80	8,20	
L	–	1,25(*)	–	
L _p	0,55	0,75	0,95	4
R	0,09	–	–	
θ	0°	4°	8°	
Tolérances de forme et de position/Tolerances of form and position				
v	0,20			
w	0,15			
y	0,10			

Ref. type	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	Notes
n	8	14	16	18	20	22	24	28	30	38	3
D _{min}	2,70	5,90	5,90	6,90	6,90	7,90	7,90	9,90	9,90	12,30	6
D _{nom}	3,00	6,20	6,20	7,20	7,20	8,20	8,20	10,20	10,20	12,60	6
D _{max}	3,30	6,50	6,50	7,50	7,50	8,50	8,50	10,50	10,50	12,90	6
Z _{max}	0,68	1,30	0,98	1,15	0,83	1,00	0,68	1,03	0,70	0,60	6

Groupe 2 – Dimensions appropriées pour le montage et le contrôle par calibre
Group 2 – Dimensions appropriate to mounting and gauging

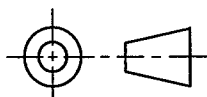
b ₂		–	0,53	4
e	–	0,65(*)	–	4
e ₁	–	7,05(*)	–	4
l ₂	–	–	1,05	4

Groupe 3 – Dimensions appropriées pour la manipulation automatique
Group 3 – Dimensions appropriate to automatic handling

A ₂	1,65	–	1,85	
D	–	–	–	Voir le type dans le groupe 1 See type in group 1
E	5,0	–	5,6	
Q	0,70	–	–	

Groupe 4 – Dimensions pour information seulement
Group 4 – Dimensions for information only

c	0,09	–	0,25	8
c ₁	0,09	0,15	0,21	8



Famille d'encombrement R-PDSO-G
Outline family R-PDSO-G

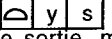
Date: 1997

1 Le dimensionnement et le tolérancement sont conformes à l'ISO 1101:1983, *Dessins techniques – Tolérancement géométrique – Tolérancement de forme, orientation, position et battement – Généralités, définitions, symboles, indications sur les dessins*.

a) (*) signifie la position géométrique véritable.

b) Les valeurs entre crochets [] sont des valeurs calculées.

c) La lettre P cerclée signifie zone de tolérance projetée.

d) Dans ce dessin  signifie que la partie inférieure de chaque sortie, mesurée depuis le plan de siège, ne doit pas dépasser la zone de profil unilatéral spécifiée y.

2 Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.

3 n désigne le nombre total de positions de sortie du type de boîtier spécifié.

4 La vérification des dimensions et des positions des sorties du boîtier est valable lorsqu'on est sûr que les sorties correspondent bien aux surfaces des pastilles de sortie. Cela peut se faire à l'aide d'un calibre approprié.

5 Une configuration d'index visible doit être située sur la face de dessus dans l'aire hachurée de la figure 1a.

6 Les dimensions "D" et "E" ne tiennent pas compte des bavures ou saillies de moulage, mais incluent les défauts de correspondance. Les bavures ou saillies de moulage ne doivent pas dépasser 0,20 mm de chaque côté.

7 La dimension b_p ne tient pas compte des bavures ou indentations dues à la barre d'arrêt. Les bavures sont admissibles jusqu'à 0,13 mm en sus de la dimension b_p lorsqu'il y a le maximum de matière. Les indentations ne doivent pas réduire la dimension b_p de plus de 0,07 mm lorsqu'il y a le minimum de matière.

8 Ces dimensions s'appliquent à la section plate de la broche située à une distance de son extrémité comprise entre 0,10 et 0,25 mm.

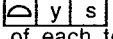
9 A1 est définie comme la distance entre le plan de siège et le point le plus bas du boîtier.

1. Dimensioning and tolerancing follow ISO 1101:1983, *Technical drawings – Geometrical tolerancing – Tolerancing of form, orientation, location, and run-out – Generalities, definitions, symbols, indications, on drawings*.

a) (*) means true geometric position.

b) [] values given within brackets are calculated values.

c)  means projected tolerance zone.

d)  means in this drawing that the lowest part of each terminal as measured from the seating plane shall not exceed the specified unilateral zone y.

2 All dimensions in millimeters.

3 n refers to the total number of terminal positions for the specified package type.

4 Check of the dimensions and positions of package terminals is validly performed when it is ensured that these terminals fit with the pattern of terminal land areas. This can be carried out by means of an appropriate gauge.

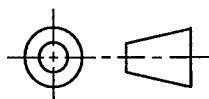
5 A visible index feature must be located on the top face in the zone shown in figure 1a.

6 "D" and "E" dimensions do not include mold flash or protrusions, but do include mismatch. Mold flash or protrusion shall not exceed 0,20 mm per side.

7 Dimension b_p does not include dambar protrusion/intrusion. Allowable dambar protrusion shall be 0,13 mm total in excess of b_p dimension at maximum material condition. Dambar intrusion shall not reduce b_p dimension by more than 0,07 mm at least material condition.

8 These dimensions apply to the flat section of the lead between 0,10 and 0,25 mm from the lead tip.

9 A1 is defined as the distance from the seating plane to the lowest point of the package.



Famille d'encombrement R-PDSO-G
Outline family R-PDSO-G

Date: 1997

ISBN 2-8318-3830-4



9 782831 838304

ICS 33.080.01
